



1650°C 알루미나 접착제 : Resbond™ 989, 989FS, 989F

1액형, 속성경화, 초미세



1650°C - Resbond™ 989

상온경화, 1액형 고순도 알루미나 접착제

부드럽고 크리미한 농도를 가지며, 상온에서 경화되어 세라믹, 흑연, 금속 및 유리에 강한 접착력을 가집니다. 금속용탕, 산화 및 환원 분위기, 대부분의 화학 물질 및 용제에 강한 저항성을 가지고 있는 접착제입니다.

■ 사용자 보고서

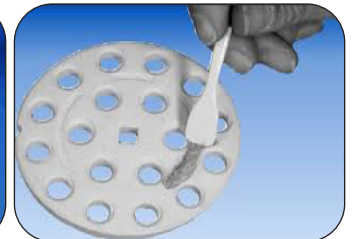
- : 알루미나 슬리브에 실리콘카바이드(초경) 노즐을 붙임
- : 가느다란 니켈 핀(0.76mm)을 질화알루미늄 세라믹에 뚫린 작은 구멍에 부착시키고, 이 부품을 900°C의 액화질소에 담금질하여도 오류없이 작동
- : 칸탈열선을 물라이트 튜브에 붙여서, 특수한 모형/규격으로 견고한 고온 히팅엘리먼트를 경제적으로 제작 가능
- : 마모 된 세라믹 부품을 재건시키고, 세라믹 전자 부품의 조립 과정에 절연과 본딩(붙이기)에 적용

■ 사용방법

- 상온에서 최소 4시간 경화 후에 65°C에서 2시간 건조하고, 특별히 내습기 성능을 높일려면 200°C에서 4시간 열경화



세라믹 전자 어셈블리를 접착 및 절연



마모 된 세라믹 부품을 재구축



989 시리즈 (Series)

1650°C - Resbond™ 989FS

속성경화(Fast set) 응용 분야를 위한 접착제

대량 생산라인의 자동 분배(투여)장비로 사용하기에 이상적이며, 가느다란 섬세한 주사 바늘을 통과하여도 엉키거나 막힘 없이 정밀하게 토출됩니다.

1650°C - Resbond™ 989F

초미세(Pre-Nano) 알루미나 접착제

600nms(0.6micron)의 초미세 알루미나 분말과 특수 고온 콜로이드(Colloidal) 세라믹 바인더가 혼합 된 접착제이며, 가장 미세한 디스펜서에 사용 할 수 있습니다.

막힘과 지저분함이 없으며, 초미세 전기 부품과 광섬유 필라멘트의 접착, 케이블 엔드 쉴, 공차가 엄격한 부품을 접착하는데 이상적인 접착제입니다.

■ 판매단위

989 : Quarter / Gallon

989FS, 989F : Pint / Quarter

■ 접착물질

카본	알루 미늄	스테인 레스	금속	세라믹	유리	플라 스틱	복합 소재
○	○	○	○	○	○		

구 분	989	989FS	989F
특징 - Feature	일반목적	속성경화	초미세
최대온도(°C) - Max. Temperature	1,650	1,650	1,650
압축강도(psi) - Compressive Strength	3,000	3,500	2800
굴곡강도(psi) - Flexural Strength	1,100	1,250	950
열팽창($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{F}$) - Thermal Expansion	4.50	4.50	4.50
열전도(BTU-in/Hr. Ft ² °F) - Thermal Conductivity	15	15	12
유전력(volts/mil.) - Dielectric Strength	200	200	200
저항률(ohm-cm) - Volume Resistivity	10^8	10^8	10^8
구성/색상 - Component/Color	1 / 흰색	1 / 흰색	1 / 흰색
농도 - Consistency	Paint	Paint	Cream
경화(hrs@R/T) - Cure	2~4	½~2	2~4
(hrs@93°C)	½~1	5 mins	1~2